

ATM-9000 ATM-9500

全自動パッケージマウンター Full-Automatic Package Mounter

【概要 - Outline -】

- ◆真空中でダイシングリングにパッケージ基板のマウントを全自動で行う装置です。
Mount packaging substrates on a dicing ring in vacuum state in the fully automatic mode.

【特長 - Features -】

- ◆真空中でテープと基板の貼り合せを行いますので段差に対しても気泡のない貼り付けが出来ます。
Lamination in vacuum state allows bubble-free lamination even on different levels.
- ◆基板の多数枚貼付に対応。
Multiple package lamination is available.
- ◆エコリングにも対応し、テープロスなしでリングにテープを貼り付けます。
Applicable to ECO ring allowing lamination without wasting tape.



仕様 Specification	ATM-9000	ATM-9500
スループット Throughput	75 フレーム /h (基板 2 枚貼り時) (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
貼付精度 Accuracy in Positioning Wafer	X, Y \pm 1.0mm θ \pm 1 度 (フレーム位置決めに対して)	\pm 1.0mm in X-Y direction and \pm 1.0 $^\circ$ in θ angle (against frame)
フレームサイズ Frame Size	2-8-1	エコリング (外径サイズ 2-8-1) ECO ring (outline diameter: 2-8-1)
使用テープ幅 Tape Width	300 mm	180 mm
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC200V 単相 Single phase 50/60Hz 3.0KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5Mpa 300NI/min
装置寸法 Demension	D 1,240 x W 1,760 x H 1,780mm (シグナルタワー含まず) (dimension for signal tower is not included)	
重量 Weight	約 800kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.